

# 2007年晶圆代工行业研究报告

## 报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2007年晶圆代工行业研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2804228042.html>

报告价格：电子版: 8000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

摘要晶圆代工行业与IC设计产业的景气密切相关，而IC设计产业在经历了2005年下半年到2006年上半年大约一年的幸福时光后，危机开始萌芽。目前，工厂生产热火朝天，导致产品生产速度超过了销售速度，结果过剩库存不断增多。半导体供应商正在实现其营业收入目标。但是，由于经济不确定性已导致PC、手机和半导体的年度预测被调低，它们仍然面临高度的不确定性。2006年前九个月供应链库存连续增长，但由于芯片厂商为了控制库存而减少生产，工厂产能利用率开始下降，随后第四季度供应链库存减少。随后，美国市场形势和工厂再度提高产量，导致库存下降趋势逆转，并导致库存在3月份上升，当时供应链中的过剩芯片库存增至2001年以来的最高水平。工厂产能利用率居高不下，正在导致当前季度的过剩库存增长。手机相关的芯片库存保持正常。模拟领域库存水平趋于正常，多数厂商的订单情况改善，尤其是高性能模拟器件。一贯高速增长的中国大陆半导体产业也放缓了脚步。2007年上半年中国大陆IC芯片总产量约192.74亿颗，较2006年同期增长15.2%；IC产业销售人民币607.2亿元，年增长率33.2%，但较2006年上半年高达48%增长率却大幅减缓。单就IC产业链来看，大陆IC设计业受MP3、数字相机等终端市场趋饱和及跌价影响，2007年上半年销售额人民币95.32亿元，年增长率仅22.8%，明显不如2006年上半年高达50.8%增长率。中星微、炬力、晶门科技这些最具中国代表性的IC设计公司，分析其表现就代表了整个中国IC设计行业的表现。在2006年全年，中星微净收入共计为1.266亿美元，而2005年则为9530万美元。中星微2006年全年按美国通用会计准则的净利润为970万美元，而2005年则为1640万美元。2007年第一季度，中星微净收入为1690万美元，而去年同期则为2640万美元。2007年第一季度，中星微按美国通用会计准则的净亏损为380万美元，而去年同期则是净利润为380万美元。不仅收入下降，利润也大幅度下滑。中星微赖以起家的是PC用摄像头的IC，经过2003、2004、2005几年高速增长后，2006年增幅开始放缓。供过于求的局面开始出现，价格被大幅度压低，中星微另一条产品线是手机多媒体IC，主要是和弦IC和应用处理器。但是手机领域，有两大不利，一是最有可能采用国产IC的国产正牌手机厂家业绩正在下滑，尤其是国内的市场份额，根本不敌国外品牌，这些企业大量寻求出口市场，而价格都被压得很低。黑手机的蓬勃兴起，导致这些厂家腹背受敌，雪上加霜。另外是手机处理器朝高集成方向发展，以前认为必须单独IC完成的拍照或MP4播放及录制都可以由单一基频完成。和弦IC由于是混合信号，难以集成，但是和弦已经被MP3铃声取代，和弦已经失去吸引力。中星微的日子将来会更难过。珠海炬力第二季度营收为2700万美元，低于去年同期的3930万美元，以及上一季度的3030万美元。珠海炬力第二季度净利润为980万美元，每股美国存托凭证摊薄收益0.11美元；去年同期净利润为1810万美元。炬力和中星微一样，高度依赖某一单一市场，炬力依赖的是MP3播放机，炬力虽然占据绝大多数的市场，但是MP3播放机市场成长速度下滑，下游厂家逼迫上游厂家降价，而这些厂家不得不降价。晶门是中国第一大IC设计公司，2006年收入为2.54亿美元，比2005年下滑36%，毛利率则下滑30%，

降到23.3%。净利润则大幅度下滑71%。该公司高度依赖LCD显示驱动IC 市场，2005年手机从STN转向TFT，而该公司未能跟上潮流，该公司20%的收入来自单色STN-LCD驱动IC，55%来自彩色STN-LCD驱动IC，而手机中TFT显示已经超过60%，TFT驱动IC的价格和毛利率都要比STN好的多，该公司不仅出货量下降14%，收入和利润也大幅度下滑。中国本土的IC设计公司根本养活不了任何一个月产能3万片的8英寸晶圆厂。并且中国IC设计公司的增幅将放缓很多，甚至出现下滑。而新的IC设计公司从创立到有成熟产品，周期通常是3-5年。中国大陆的IC设计公司全部是海归派创立的，他们套用国外的模式，投资基本都来自风险投资。受市场不景气的影响，中国上市的IC设计公司股价表现很差，例如展讯，刚上市不到一星期，即跌破发行价30%。中星微也跌破发行价，只有发行价一半的价格。炬力也是如此。如此一来，晶圆代工厂必须依靠海外业务，实际现在中国的晶圆代工厂80%以上的收入来自海外客户，有些甚至是100%。这就意味着要和联电、台积电竞争。由于台湾的技术封锁，大陆晶圆厂技术落后台湾大约2-3年。而这种技术差距短期内很难弥合，因为大陆在此领域严重缺乏本土人才。因此只能找到那些联电和台积电不愿意做的业务来做，这些通常是DRAM内存、NVM等。这些业务毛利率低，风险波动大。不过中国仍旧在晶圆代工领域高歌猛进，投资的脚色由企业变为政府。成都、武汉和西安政府都投入巨资进入晶圆代工领域。政府投资，银行贷款，企业租赁，一定期限后收购，这种独特的中国特色越来越常见。这些晶圆厂未来如何发展，2008年就可以见分晓。

正文目录第一章：晶圆制造简介1.1、晶圆制造流程1.2、晶圆制造成本分析第二章：全球半导体制造产业2.1、全球半导体产业概况2.2、全球晶圆代工行业概况第三章：中国半导体产业与市场3.1、中国半导体市场3.2、中国半导体产业3.3、中国IC设计产业3.4、中国半导体产业发展趋势第四章：晶圆代工厂家研究4.1、中芯国际4.2、上海华虹NEC电子有限公司4.3、上海宏力半导体制造有限公司4.4、上海先进半导体4.5、和舰科技（苏州）有限公司4.6、BCD（新进半导体）制造有限公司4.7、方正微电子有限公司4.8、珠海南科4.9、无锡华润微电子4.9.1、无锡华润上华4.9.2、无锡华润晶芯4.10、台积电4.11、联电4.12、特许4.13、东部亚南DongbuAnam4.14、世界先进4.15、MagnaChip4.16、Silterra4.17、X-Fab4.17.1、1stSilicon4.18、Tower Semiconductor

图表目录 原始晶圆的加工流程图晶圆植入电路的流程图8英寸晶圆成本结构分析2006年全球24大半导体公司排名（不计晶圆代工）2006年全球50大半导体公司排名1997-2006年晶圆代工厂客户结构2006年晶圆代工厂制程收入结构比例2004年1季度到2008年4季度全球晶圆代工厂产能利用率统计及预测1996-2006年全球IC设计公司收入与增幅统计2006-2011年全球晶圆代工厂收入预测2004-2010年北美IC设计公司产品制程结构比例2006-2010年中国IC市场需求与供给统计2001-2006年中国IC进出口金额统计2006年中国IC进口制程比例结构2006年中国IC出口制程比例结构2000-2009年中国大陆IC设计公司收入与增幅统计2002-2006年中芯国际收入统计图 中芯国际快速成长图图 中芯国际通过的质量标准2006年1季度到2007年2季度中芯国际产品下游应用结构2006年1季度到2007年2季度中芯国际产品结构2006年1季度到2007年2季度中芯国际客户类型结构2006年1季度到2007年2季度中芯

国际收入地区结构中芯国际技术状况图 上海华虹NEC工艺路线图MLM工艺图  
宏力半导体逻辑类技术的发展规划图 宏力半导体闪存类技术的发展规划上海先进半导体未  
上市前股份结构上海先进半导体上市后的股份结构ASMC历史2007年1季度先进半导体产品  
下游应用结构比例2007年1季度地域收入结构比例2005年1季度到2007年1季度先进半导体  
每季度收入与毛利率统计2005年1季度到2007年1季度先进半导体每季度产能与产能利用率  
统计2005年1季度到2007年1季度先进半导体每季度产能利用率与毛利率统计图  
BCD产品分类图 BCD系列产品 图 BCD系列产品 图 BCD系列产品 图5-18 BCD系列产品  
珠海南科晶圆代工流程华润上华公司组织结构图2002-2006年华润上华收入与净利润率统  
计2002-2006年华润上华地域收入结构2002-2006年华润上华生产工艺收入结构2002-2006  
年华润上华产品收入结构类型华润上华技术路线图华润上华标准工艺代工流程图华润晶芯技  
术路线图2003-2006年台积电收入统计2003-2006年台积电员工数量统计台积电05年Q3到07  
年Q2产品技术类型结构台积电05年Q3到07年Q2产品应用结构台积电05年Q3到07年Q2收入  
地域结构台积电05年Q3到07年Q2客户结构台积电产品技术路线图台积电 服务路线图台积  
电员工学历结构2000-2006年联电收入与毛利率统计联电2000-2007年产能变化2004-2006  
年联电人员学历结构联电 2007年2季度地域收入结构联电 2007年2季度收入客户结构联电  
2007年2季度产品应用收入结构联电 2007年2季度收入工艺结构联电技术路线图1998年到2  
006年特许半导体收入与净利润率统计特许半导体2006年3季度到2007年3季度收入统计及  
预测2004年1季度到2007年3季度IBM与特许半导体合作大事记特许半导体各领域合作伙伴  
特许半导体5座晶圆厂实景特许半导体特殊工艺产品技术路线图特许半导体2006年2季度到2  
007年2季度晶圆产能与产能利用率统计特许半导体2006年2季度到2007年2季度下游产品应  
用比例结构统计特许半导体2006年2季度到2007年2季度地域收入结构比例2003-2006年特  
许半导体产能统计东部亚南工艺路线图2006年2季度到2007年2季度世界先进收入、毛利率  
与产能利用率统计2006年2季度到2007年2季度世界先进产品工艺结构2006年2季度到2007  
年2季度世界先进产品下游应用结构2006年1季度到2007年2季度世界先进产品具体应用结构  
世界先进技术路线图世界先进OTP产品和闪存技术路线图世界先进高压工艺技术路线图200  
2-2006年MAGNACHIP收入与毛利率统计2004-2006年MAGNACHIP收入结构统计2006年M  
AGANACHIP地域收入结构Silterra逻辑与混合信号技术路线图Silterra高压工艺技术路线图X-  
FAB技术路线图X-FAB MEMS技术路线图1stSilicon逻辑与混合信号技术路线图1stSilicon特  
殊工艺技术路线图Tower Semiconductor技术路线图Tower Semiconductor microFLASH 技  
术路线图2007年1季度全球10大IC设计公司2006年全球10大晶圆代工企业排名中国大陆已  
经投产6英寸以上晶圆代工厂一览2006年中国大陆前八大IC制造企业排名2006年中国十大IC  
设计公司排名2006年台湾二十大IC设计公司排名表 中芯国际主要晶圆代工厂情况表  
宏力主要产品的设计规则表 宏力0.25微米工艺技术主要特性表  
0.25微米器件的电性设计参数表 宏力0.15微米技术的主要工艺参数表  
0.15微米器件的电性设计参数 ( EDR ) 表 BCD产能一览珠海南科晶圆代工报价华润微电子

产品类型台积电晶圆厂一览台积电人员职务构成表台积电45纳米工艺特性表台积电混合信号/射频工艺特性表台积电 硅锗BiCMOS工艺特性表台积电高压工艺特性表2007年2季度联电晶圆厂产能一览联电主要转投资公司一览2004-2006年联电人员结构比例联电混合信号/RFCMOS工艺特性表联电CMOS图像传感器工艺特性表联电高压工艺特性表特许半导体2006年2季度到2007年2季度各晶圆厂产能统计特许半导体2006年2季度到2007年2季度工艺结构比例东部亚南130纳米工艺特性表东部亚南CMOS图像传感器IC工艺特性表东部亚南高压工艺特性表世界先进逻辑电路制程特性世界先进混合电路制程特性世界先进高压电路制程特性MAGNACHIP 各晶圆厂一览1stSilicon工艺特性表

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2804228042.html>